

证券代码：688456

证券简称：有研粉材

有研粉末新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表（2024年11月12日）

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称 | 中信建投证券、民生证券、国信证券、华创证券、五矿证券、中邮证券、招商证券、国联证券、华夏基金、国新投资、中银三星人寿、英大资产、长信基金、益民基金、诺安基金、泰康资产、风炎投资、华商基金、衍航投资、新华养老保险、新华基金、振源资产、中和资本、经纬综合、上银基金、华创自营 |
| 会议时间 | 2024年11月12日 14:00-15:30 |
| 会议地点 | 有研大厦 |
| 上市公司接待人员 | 董事会秘书、财务总监、总法律顾问：姜珊 副总经理、有研合肥执行董事、总经理：刘祥庆 有研增材副总经理：赵新明 有研纳微执行董事、总经理：朱捷 证券事务代表：王妍 证券事务专员：瓮佳星 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | Q1：介绍公司情况及截至三季度经营情况。 A1：有研粉材成立于2004年，控股股东中国有研科技集团是国务院国资委所属中央一级企业，有研粉材属于二级中央企业。公司业务分为四个板块，包括铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料、3D打印用粉体材料和电子浆料。公 |

司铜基金属粉体材料目前在国内市场占有率约 35%，产销量国内第一、全球第二，主要应用于粉末冶金、金刚石工具、摩擦材料、催化剂、电碳电刷、散热器件等下游领域，该板块的公司有有研合肥、有研重冶和境外的有研泰国、英国 Makin 公司；微电子锡基焊粉材料目前在国内市场占有率约 15%，国内第一，该板块公司有康普锡威及其子公司；3D 打印用粉体材料运营的公司为有研增材，与 2021 年底成立，产品除了 3D 打印用粉体材料还包括一些高温特种粉体材料如软磁、MIM 粉等，3D 打印用粉体材料应用于航空航天、JG、汽车、模具钢等领域，产品在市场上具有一定特色；电子浆料是公司目前重点发展的新板块，2023 年成立有研纳微，与微电子锡基焊粉材料都属于微电子互连材料，是电子封装/组装必不可少的材料，广泛应用于电子制造业的半导体封装、电子元器件装配、高效光伏电池等，下游主要应用于消费电子、半导体、光伏、LED 照明/显示等。

公司前三季度整体销量 23,000 吨，同比增长 10%，营业收入 23 亿元，同比增长 18%，其中销量增长带来的增量是 11%，由于原材料价格上涨带来的增量是 7%。利润总额 4,489 万元，同比增长 3%。

Q2：公司新研发的导热铜粉的优势有哪些。

A2：与传统雾化铜粉相比，导热铜粉具有梯度孔隙结构、比表面积发达、松装密度低等特点，现已成功应用于部分 GPU 散热器件。该产品是公司与某终端用户合作开发的产品，目前国内只有公司可以生产，属于行业内比较大的进步。据了解该产品目前已经部分应用于 AI 算力服务器、基站、大型路由器、交换机等场景，应用效果截至目前反馈良好。目前实现每月小批量吨级销售，未来是否能进一步拓展应用领域，尚需等待客户验证成果。

Q3：导热铜粉在应用领域的拓展有哪些困难？

A3：导热铜粉应用的是一种新的产品结构，因前期研发周期长投入较多，因此新产的价格高于传统产品价格，下游产品的研发设计人员在选择应用哪种产品时会考虑成本因素，以及与新产品的性能契合度。但目前一些散热组件厂商已经完成对公司该产品的热性能测试等基础工作，未来可能在合适的时机逐步推广。

Q4：公司铜粉未来发展的亮点有哪些？

A4：公司目前铜基板块国内市场占有率第一，未来粉体制造的主要目标是高纯、超细、超低松比，通过提高产品附加值，向新的应用领域拓展、延伸，未来发展空间很大。如公司的新型导热铜粉，现已成功应用于 GPU 散热器件。公司还有电子级氧化铜粉等产品在研发试制。同时，随着泰国募投项目

的落地，公司将进一步扩大国际市场的占有率。

Q5: 关注到 3D 打印产品的毛利水平达 40%，下游主要是军工企业，今年的出货量怎么样？

A5: 截至十月，公司 3D 打印粉体销售量达到 2023 年全年销售量的 2 倍，预计年底可以达到 3 倍。

Q6: 公司 3D 打印粉体在下游军工主要是哪些领域的应用？

A6: 航空领域很多新产品都有有研增材公司的产品，另外商业航天领域公司也已介入，不论是火箭还是卫星都会有相应的产品应用。

Q7: 3D 打印粉体的销量占比分别有多少？公司明年 3D 打印粉体销量预期有多少？

A7: 公司目前销量最大的是铝合金产品，其次是不锈钢和高温合金。公司明年 3D 打印粉体销量目标翻一番。3D 打印整个行业仍处于刚起步阶段，公司看好该板块未来的发展潜力。在德国法兰克福即将举办的精密成型及 3D 打印制造展览会 Formnext，是欧洲乃至全球首屈一指的 3D 打印、增材技术展览会，公司会参展并扩大在行业内的影响力和知名度，提升公司的竞争力。

Q8: 公司在 3D 打印产品的核心竞争力体现在哪些方面？

A8: 公司研发团队在增材制造用球形金属粉体制备技术方面较早开展工作，同时作为有研科技集团所属团队，在新材料开发、低成本、高品质制备增材制造用金属粉体方面具有较多的经验和技術积累，在科技成果转化和产业化方面具备一定经验。公司产品陆续收到了国外客户的订单，产品性能在国际市场上具备了较强的竞争优势。

Q9: 特朗普上台以后对公司出口是否有影响？

A9: 事件对公司整体没有过多影响，部分板块有可能会因此获益。为有效化解美国单边贸易保护主义政策带来的不利影响，防范未来其他西方国家采取贸易保护政策带来的潜在市场风险，增强全面抵御相关风险的能力，公司几年前已开始布局建设海外生产基地，扩张海外市场，泰国生产基地于今年 6 月建设完成并正式投产，取得产能出海阶段性成果，未来能够与英国生产基地共同为公司推进海外业务布局、践行产业全球化发展战略做出贡献，为实现公司创建世界一流的金属粉体材料供应商的目标发挥重要作用。

Q10: 公司毛利率为什么不高，这两年也一直下降？

A10: 公司产品采用原材料加加工费的定价模式，毛利率适用的是总额法，在原材料占比基数非常大的情况下，毛利率

就不会太高。这几年铜、锡等金属原材料价格不断上涨，导致基数变大，毛利率被动下降。

Q11: 公司未来海外基地放量，毛利率会不会有明显提升？

A11: 公司整体毛利的提升是各方面综合采取举措的一个结果。行业本身定价模式决定了毛利率就比较低，另外目前行业内竞争比较激烈，公司在保证市场占有率的同时会牺牲部分利益。未来公司会通过调整产品结构、扩大市场占有率、优化生产工艺、控制生产成本等方式提高毛利。

Q12: 公司有些骨干没有股权激励，是否会考虑用股权激励来留住人才？

A12: 公司上市前做过一次国有企业股权激励，随着公司这几年业务的拓展，新加入的核心业务骨干员工没有持股，所以公司在考虑筹备上市公司股权激励，吸引和留住人才。

Q13: 公司在光伏领域有没有铜浆的应用？

A13: 公司在几年前参加过科技部的国际合作项目、北京市重点研发计划，有对铜浆的应用研究，当时主要应用于三代半导体。有了这样的技术积累，今后铜浆研发应用于哪些场景，主要考虑市场的应用成本，高温银浆和低温银浆技术路线不同，银包铜替代的有可能以高温银浆为主，银包铜场景的异质结、IBC 等低温银浆，铜浆在粉体、载体部分都会有技术区别，公司也在关注并紧跟市场技术路线，等待市场批量化使用的行业信号。

Q14: 铜浆现在有做一些小批量的生产还是处在实验室研发阶段？

A14: 批量化生产需要有市场匹配度，下游客户目前还处于摸索和探索阶段，产品成熟度没有达到相应级别，属于研发阶段。公司通过前期的项目参与已经做好相应的积累技术，等待市场爆发。

Q15: 公司在 3D 打印上的战略规划是怎样的。

A15: 公司也在不断摸索适合 3D 打印发展的最优模式。在公司的募投项目中有科技创新中心建设项目，公司计划通过该项目向增材制造领域加大投入规模，建设增材制造数字产业中心，增加不同种类的打印设备，提升设备的多样性、丰富产品结构，建立全流程 3D 打印服务产业链，为公司增加销量、承接未来一些重大专项做好准备。

Q16: 泰国基地投产情况预期？

A16: 泰国公司总产能 5000 吨，今年 6 月之后投产运行，计划销量 1000 吨，目前进展顺利超过预期，预计第四季度单

| | |
|---------|--|
| | <p>季度可以实现盈利，明年会有比较好的增长预期。</p> <p>Q17: 英国 Makin 公司今年的营收情况? A17: 公司于 2013 年收购的英国 Makin 公司，自收购以来整体经营情况不错，该公司 2023 年度利润不高，是因为其销售以欧洲市场为主，2023 年欧洲市场整体低迷，同时部分能源价格大幅增长、汇兑损失增加，导致成本费用增加、利润减少。2024 年以来，英国 Makin 公司市场需求逐步恢复，经营业绩持续向好，预计明年营收情况也有所增长。</p> <p>Q18: 公司产品的其他亮点? A18: 结合国家设备更新、发展新质生产力的政策，公司不断调整产品结构，开发新的产品，形成新的产业链，如复合铜粉、超细铜粉、低松比铜粉、电子级氧化铜粉等高附加值产品。同时根据市场能源转型需求，公司不断加强创新能力，加大研发投入，研发纳米材料、银包铜粉等新产品，应用于 PCB、MLCC 等产品，满足市场需求，成为公司新的利润增长点。</p> <p>Q19: 公司未来发展规划如何? A19: 公司未来以创新引领发展，以新产业为主导，重点发展 3D 打印板块和电子浆料板块，目前 3D 打印行业虽然进入者很多，竞争非常激烈，但我们分析仍出于行业爆发前期，行业容量大，每年约有 25%左右的增速。公司在很早之前已经进入这个行业，当时以研究开发为主，在 2017 年获得了国家科技进步二等奖。公司之前的发展主要聚焦于粉体材料本身，未来会逐步推进向下游的延伸发展。为此公司已经开始布局，公司依托科创中心的募投项目，对 3D 打印板块进行投入，建立实验室、购置 3D 打印机，增加对粉体材料的验证环节，缩短客户的验证周期，预计到 2025 年底完成建设。同时，在提高 3D 打印粉末制备能力上持续加劲，计划通过建立新基地，实现规模生产。电子浆料板块还处于技术研发阶段，但属于未来产业，将继续融入国家战略，保障产业链供应链安全稳定，加快传统产业转型，打造战略性新兴产业，在中国式现代化建设中展现央企责任担当，以更加优异的业绩回报广大投资者。</p> <p>Q20: 公司有并购的想法吗? A20: 与同行业公司相比，公司在研发水平、工艺技术、成本控制、产品种类、资金支持和客户服务方面都具备一定优势，但下游领域开发、市场开拓方面有一些不足，如增材制造、电子材料产业链方向，有在做战略规划，一切以公司信息披露的公告为准。</p> |
| 关于本次活动是 | 不涉及 |

| | |
|--------------------|-------------|
| 否涉及应当披露 重大信息的说明 | |
| 附件清单（如有） | |
| 日期 | 2024年11月15日 |